

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-30

投资者关系 活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	国金证券、招商基金、申万宏源证券、元大证券、平安证券、华商基金、华安基金、中汇人寿、野村东方国际证券、三井住友德思资管、晨曦私募、趣时资产、拾贝投资、敦和资管、广州市圆石投资、中信证券、北京颐和久富投资、银叶投资、巨子私募、高毅资产、淳厚基金、西格玛资产、光大证券、运舟私募
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；证券事务主管：阳佩琴
时间	2025 年 9 月 9 日-11 日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年上半年度经营业绩情况。 公司把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化趋势深化的发展机遇。2025 年上半年，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 25.63%，归母净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。 PCB 业务受益于 AI 加速卡、服务器等产品需求的释放，高速交换机、光模块需求的显著增加，以及汽车电子市场需求的增长。PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%，业务毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点；封装基板业务主要受益于国内存储市场需求的回暖，公司在持续聚焦能力建设的同时，加速推进市场开发，推动订单收入增收。封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点；电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。电子装联业务实现主营业务收入 14.78 亿元，同比增长 22.06%，毛利率 14.98%，同

比增长 0.34 个百分点。

Q2、请介绍 2025 年上半年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。

PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

2025 年上半年，PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%；业务毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点。PCB 业务把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。营收层面的增长贡献主要为 AI 加速卡等产品需求释放，数据中心领域占比进一步提升；400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著提升，有线侧占比增加；以及汽车电子需求增长。毛利率在营收规模增加、产能利用率相对高位、产品结构优化的情况下亦有所提升。

Q3、请介绍 2025 年上半年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。

2025 年上半年，封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点。公司封装基板业务把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单较去年同期显著增长。封装基板业务毛利率同比下降，主要由于广州封装基板项目处于产能爬坡阶段，金盐等部分原材料涨价，使得成本及费用较同期增加。

Q4、请介绍公司 2025 年上半年 PCB 业务产品下游应用经营情况。

公司在 PCB 业务方面从事中高端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

2025 年上半年，通信、数据中心、汽车电子等领域对 PCB 业务营收增长均有贡献。在通信、数据中心领域，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，AI 加速卡、服务器等相关配套产品的需求提升，营收增长明显。在汽车领域，公司继续把握汽车电子需求增长的发展机遇，实现了订单收入的增加。PCB 业务毛利率的增长主要得益于营收规模增

加，PCB 工厂产能利用率进一步提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在 AI 算力方面的布局情况。

伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024 年以来，公司 PCB 业务在通信交换机及光模块、数据中心 AI 加速卡等领域的 PCB 产品需求均受益于上述趋势。

Q6、请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。

公司 PCB 业务因算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。

Q7、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。PCB 新增的产能主要来自于两个方面，一方面公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级；另一方面，公司有序推进南通四期项目及泰国工厂建设，南通四期项目预计今年四季度连线，泰国工厂目前已连线。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q8、请介绍广州封装基板项目连线及产能爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡阶段，重点仍聚焦能力建设及市场开发，2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

Q9、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。

	Q10、请介绍公司 PCB 产品对 HDI 技术的应用情况。 HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。 Q11、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。 公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无